

Manual Update Sheet

已停产并重新设计的 **TDA2P、DRA7xxP、AM574x** 封装



摘要

本文档应与器件数据表配合使用，其中介绍了所示器件的更新封装符号。

1 封装重新设计详情

说明

采用 FCCSP 封装技术的 TDA2P、DRA7xxP 和 AM574x 器件采用 FCBGA 封装进行了重新设计。这种 FCBGA 封装提供了与数据表类似的电气性能。其占用空间也与最初的封装相当。

引用器件数据表时，通篇使用新的封装符号代替已停产的封装符号。

有关更新后的封装图，请参阅以下页面

表 1-1. 封装符号

旧封装符号	新封装符号
ACD	APB
ABZ	AQF

废止原因

由于收到基板供应商的设备停产通知，我们将逐步停止提供一些 FCCSP 封装并告知最后可采购期限。这些器件现已转为采用 FCBGA 封装。

受影响的器件

下表介绍了受影响的器件、新旧封装符号以及引用的器件数据表内容。

器件	已停产器件型号	新器件型号 ⁽¹⁾	数据表
DRA76P	DRA76xPx..x ACDQ1	DRA76xPx..x APBQ1	SPRS993
DRA77P	DRA77xPx..x ACDQ1	DRA77xPx..x ACDQ1	SPRS993
TDA2P	TDA2Px..x ACDQ1	TDA2Px..x ACDQ1	SPRS996
DRA74P-ABZ	DRA74xPx..x ABZQ1	DRA74xPx..x AQFQ1	SPRS989
DRA75P-ABZ	DRA75xPx..x ABZQ1	DRA75xPx..x AQFQ1	SPRS989
TDA2P-ABZ	TDA2Px..x ABZQ1	TDA2Px..x AQFQ1	SPRS990
AM574x-ABZ	AM574..x ABZ	AM574..x AQF	SPRS982

(1) 请注意，TI 正在减少将支持的“新器件型号”总数，因此新旧器件型号可能不是完全匹配的。请参阅数据表的“封装选项附录”了解可用的器件型号，或联系您的 TI 代表确定应使用的相应新器件型号。

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#))、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2025 , 德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期 : 2025 年 10 月